



	2024/10/14		2024/10/15	
	上午	下午	上午	下午
新质生产力驱动制造业高质量发展				
现场会议室 Onsite Conference Room	AI+运控+机器人与汽车电子智造创新应用大会		2024 (第二届) 半导体及高端电子用胶创新论坛	
现场会议室 Onsite Conference Room	miniled先进制造产业高峰论坛		2024年新能源汽车线束及连接器创新技术论坛	



AI+运控+机器人与汽车电子智造创新应用大会

会议背景

随着人工智能（AI）、运动控制（运控）和机器人技术的飞速发展，这些先进技术正在逐渐改变各个行业，特别是汽车电子智造领域。AI提供了智能决策和优化能力，运控技术提高了机器运动的精度和稳定性，而机器人则实现了自动化和高效生产。这些技术的融合为汽车电子智造领域带来了前所未有的创新机会，特别是对各电子行业行业高精度、高效率和高可靠性的生产需求日益增长。为了满足这些需求，行业内对AI、运控和机器人技术的应用也提出了更高的要求。企业需要探索如何将这这些先进技术应用于生产过程中，以提高生产效率、降低成本并提升产品质量作为重要的关键技术。

本次会议将汇聚行业专家、企业领袖和学术界精英，共同AI、运控与机器人技术发展趋势，汽车电子智造行业现状与挑战，AI+运控+机器人在汽车电子智造中的应用前景、技术挑战和未来发展方向。

2024议题大纲

- 协作机器人与电子智造行业的融合之旅:智能变革的先锋力量
- 运控控制与新能源汽车电子行业未来引擎
- 数字化、低碳化“双轮”驱动电子行业智造未来
- 新能源汽车电子驱动系统解决方案
- “AGV+机械手”的复合机器人赋能行业新业态
- AI赋能电子制造，引领新业态



miniled先进制造产业高峰论坛

会议背景

2028年，全球整体Mini/Micro LED市场规模将达到360亿美元，未来5年的市场复合增长率保持在50%以上。随着Mini/Micro LED应用市场的逆势成长，正加速应用落地和陆续量产，Mini/Micro LED迎来高速发展阶段。

为加强国内Mini/Micro LED 产业链上下游企业之间的交流与合作，推动Mini/Micro-LED产业的快速发展，凝聚共识、聚焦创新应用，促进行业健康可持续发展。慕尼黑华南电子生产设备展同期会议将邀请Mini/Micro-LED原材料、制造及应用企业共话Mini/Micro-LED产业的未来前景、技术壁垒等，旨在搭建产业链企业家分享和交流的互动平台。

2024议题大纲

- Mini/Micro-LED市场现状以及前景
- Mini/Micro-LED制程工艺
- AIAOI助力Mini-LED产业发展
- Mip未来趋势
- COB技术突围及发展趋势
- 巨量转移关键技术与装备研究现状



2024年新能源汽车线束及连接器创新技术论坛

会议背景

汽车线束是汽车电路的网络主体，具有耐热、耐油性、耐冷等特性，同时它富有柔软性，用于汽车内部联接，能适应高机械强度，高温环境中使用。新能源汽车中以网联化、智能化为代表的高频高速传输应用日益增多，传统车载数据传输总线已无法满足相应应用场景下的高频率和高带宽的要求，车载以太网的引入不仅可支持高速传输，且具有标准化的链路连接形式，减少了全车的电缆连接数量，从而降低了成本。高压线作为动力传输载体，要求其制作必须精密，导通性需要满足强电压、强电流；屏蔽层处理难度大、防水性等级要求高，这为高压线束的加工产生了一定的难度。本次论坛将从产业发展、技术创新、解决方案等方面探讨分析新能源汽车线束及连接的技术发展和行业需求大方向，通过分享实践经验、深入探讨创新解决方案。

2024议题大纲

- 高速车载以太网传输方案和发展趋势
- 汽车以太网高速传输电缆的应用与技术发展趋势
- 电磁兼容性（EMC）屏蔽技术和优化布线方案
- 新能源汽车动力系统线束和连接器的设计和要求
- 汽车高压汽车高压线缆的应用与技术发展趋势
- 汽车高压线束加工的智能化解方案



2024（第二届）半导体及高端电子用胶创新论坛

会议背景

近几年，5G、人工智能、智能手机、新能源汽车、物联网等新兴产业迅猛发展，拉动了我国包含半导体在内的高端电子产业的高速发展，继而带动了高端电子用胶产业的快速发展。2022年我国电子胶粘剂总体消费金额约120亿元，其中半导体封装用胶约占52%。半导体材料是半导体制造工艺的核心基础，其中半导体用胶粘材料是重要组成部分。当前，我国半导体材料国产化进程正在加速，胶企如何把握这一历史机遇，适应高要求、高标准、高附加值的半导体和高端电子用胶产业的高速发展！为推进胶企精准把脉中国半导体及高端电子用胶市场与技术最新发展趋势和机遇，助推中国高端电子用胶产业快速高质发展，粘接资讯、新材料产业联盟、慕尼黑华南电子生产设备展等单位特联合携手于10月14-15日在深圳举办“2024（第二届）半导体及高端电子用胶粘材料创新论坛暨2024先进电子点胶及胶粘剂技术论坛”。

2024议题大纲

- 新型导电胶在5G、汽车电子等产业中的应用
- 芯片级和板级封装的高端电子胶粘剂的应用
- 有机硅胶粘剂在新能源上的应用
- 点胶工艺在新型显示的创新解决方案